산업통상자원부 보도참고자료 당시 대한민국! 새로운 국민의 나라

보도시점 2023. 9. 29.(금) 배포즉시 배포 2023. 9. 29.(금)

미국 상무부, 반도체법상 3억불 미만 소재·장비 제조시설 투자에 대한 지원기준·절차 발표

- 소규모 투자 대상임을 고려하여 기존 지원기준·절차 일부 완화 및 변경 -
- 중국 내 설비확장 제한은 소재·장비 기업에게는 미적용-

9월 29일(금) 18시(한국시간) 미국 상무부는 미 「반도체과학법(이하 반도체법)」상의 인센티브 프로그램 중 3억 달러 미만 소재·장비 제조시설 투자*에 대한 재정 인센티브의 세부 지원계획(NOFO, Notice of Funding Opportunity)을 공고했다.

* 다만, 미 상무부는 2천만 달러 미만 투자는 지원대상이 되기 어렵다는 입장

「반도체법」에 따라 美상무부에서 운영하는 재정 인센티브는 ❶반도체 제조시설, ❷반도체 소재·장비 제조시설, ❸R&D 시설 투자에 대한 지원으로 구성되어 있다. 금번 공고는 지난 △반도체 제조시설(2.28일 발표), △웨이퍼 제조시설 및 3억 달러 이상 소재·장비 제조시설(6.23일 발표) 투자에 대한 세부 지원계획에 이어서 세 번째로 발표된 세부 지원계획이며, R&D 시설 투자에 대해서는 추후 발표될 예정이다.

美상무부는 금번 공고를 기존의 세부 지원계획과 별도의 문서로 공고하였으며, 소규모 투자를 대상으로 함을 고려하여 기존에 발표된 지원기준 및 절차를 다소 완화하거나 변경하였다. 이에 따라 △대출(보증)은 제외하고 직접보조로 지원하며, △지원 규모는 일부 예외*는 있으나 투자액의 10%를 지원(←5~15%)한다.

* 경제·국가안보상 강점이 있거나 상업적 생산을 위한 추가 지원이 필요한 경우 20%/30% 지원 가능

또한, △요구조건에 있어서도 美상무부는 반도체 제조설비와의 연계 등을 통한 공급망 강화를 강조*하는 한편, 초과이익 공유, 보육서비스 제공 의무 등의 요건은 제외되었다. 또한, △신청절차도 변경되어 신청기업들은 계획서**를 제출(`23.12.1~`24.2.1)하고 동 계획서를 기반으로 美상무부가 선정한 기업들이 별도의 본 신청을 진행한다.

* 단독 프로젝트가 아니라 컨소시엄으로 참여하는 프로젝트로도 신청 가능(각종 요건 충족에 유리)

** 계획서 평가는 점수제 포함→반도체 제조 클러스터와의 연계(40점), 상업적 실행가능성(20점), 반도체법상 지원 필요성(10점), 프로젝트 성공가능성(15점), 반도체법상 지원 외 수혜 여부(15점)

한편, 9월 22일 발표된 가드레일 세부 규정 최종안에 따르면 소재 및 장비 제조시설 투자는 중국 내 설비확장 제한을 적용받지 않는다.

우리 업계는 금번 공고를 바탕으로 美상무부의 인센티브 프로그램 구체 검토, 대응하겠다는 입장이다. 정부는 금번 공고가 업계에 미치는 영향을 업계와 긴밀히 논의하고, 우리 기업의 원활한 투자·경영활동을 지원하기 위하여 美정부와 협력해 나갈 계획이다.

담당 부서	첨단산업정책관 반도체과	책임자	과 장	이규봉 (044-203-4270)
		담당자	사무관	정은지 (044-203-4273)
	통상정책국 미주통상과	책임자	과 장	안홍상 (044-203-5650)
		담당자	사무관	이동욱 (044-203-5658)

대한민국 정책브리핑
OPEN 출처표시
공공누리 공공저작물 자유이용허락